

2024 第三届全国电子信息材料与器件大会

3th National Conference on Electronic Information Materials and Devices

邀请函

尊敬的_____先生/女士：您好！

热忱欢迎您参加“2024 第三届全国电子信息材料与器件大会暨“电子信息与未来”科学家论坛”，会议由电子信息材料与器件专家委员会主办，电子科技大学承办，定于2024年4月12-15日在杭州召开。

“全国电子信息材料与器件大会”是由电子信息材料与器件专家委员会组织发起召开的全国性学术会议，每年举办一次，是领域内卓有成效的学术交流平台和新成果发布渠道。

会议旨在通过聚集国内科技工作者及产业单位，围绕领域内研究的重点、热点、前沿及关键共性科学问题展开研讨，分享最新成果，探讨基础研究思路和优先发展方向，推进技术进步和产业化协同，把握科研和产业的发展趋势，推动产学研合作与跨越发展。

在此，我们诚挚地邀请您出席，您的参与和帮助，是大会成功的重要保证。

现将有关安排告知如下：

一、时间、地点：2024年4月12-15日 杭州

二、会议官网：www.c-nmaterial.com.cn/en.php

三、组织机构

主办单位：电子信息材料与器件专家委员会

承办单位：电子科技大学、北京中科智材新材料科技发展中心、北京高科前沿科技发展中心

名誉主席：沈学础、褚君浩、毛军发、朱诗尧、罗先刚、郑婉华、包为民、顾敏、张学记、陈晓红、徐洪坤

大会主席：王志明、张大伟、唐为华、毕文刚

三、会议内容（包括但不限于）

半导体、微电子和集成电路；光电子材料、器件与集成；集成光子学、光子材料与器件；微纳光学、光电材料与器件；激光技术、激光材料与器件；光电探测与智能传感；电子信息与生物医学应用；新型智能（智慧）材料；

四、会议注册（食宿自理）

注册类型	3.10 日前	现场	付款方式
普通代表	3000	3200	1、户名：北京中科智材新材料科技发展中心 账号：0200250109200790477 开户行：中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行 2、户名：北京高科前沿科技发展中心 账号：9550880223115100198 开户行：广发银行股份有限公司北京和平里支行
会员代表	2800	3000	
学生代表	1800	2000	
企业代表	3200	3500	
线上参会	1500/人		

现场收费说明：现场注册（缴费）代表，由“青岛德乐会务服务有限公司”收取会议费并开具发票

全国电子信息材料与器件大会

组委会

北京中科智材新材料科技发展中心 北京高科前沿科技发展中心